



D1 DACH

Blachodachówka	
Łaty 5x4	4cm
Kontrłaty 5x3	3cm
Wiatroizolacja	
Krokwie 8x18cm/wełna mineralna	18cm
Stelaż stalowy do mocowania	
plyt g/k / wełna mineralna	15cm
Paroizolacja	
Płyty g/k (GKI pom.mokre)2x12,5m	2,5cm

D2 DASZEK NAD WEJŚCIEM

Hydroizolacja + membrana PCV	
Termoizolacja + warstwa spadkowa	
Płyta żelbetowa ze spadkiem	16-19cm
Izolacja termiczna	20cm
Tynk silikonowy	1,5cm

P2 PODŁOGA PODDASZA

Wykończenie gres/ panele	2cm
Wylewka bet. zbrojona Ø6 co 15cm	6cm
Styropian EPS100-0,38	8cm
1 x folia PE	
Płyta żelbetowa	18cm
Tynk cementowo-wapienny	1,5cm

P1 PODŁOGA PRZYZIEMIA (na gruncie)

Wykończenie (gres, panele)	2cm
Wylewka bet. zbr. siatką Ø6 co15cm	6cm
1 x folia PE	
Styropian EPS100-0,38	7cm
Płyta fundamentowa 25cm	25cm
XPS	15cm

Sz1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA IZOPassive (tynkowana)

Tynk silikonowy	1,5cm
Styropian	25cm
Beton	15cm
Styropian	5cm
Tynk cementowo-wapienny	1,5cm

Sz3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA IZOPassive (okładzina elewacyjna)

Okładzina elewacyjna Greinplast OEA-L	
Styropian	25cm
Beton	15cm
Styropian	5cm
Tynk cementowo-wapienny	1,5cm

Sw2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA Silka (działowa)

Tynk cementowo-wapienny	1,5cm
Błoczek silikatowy	12cm
Tynk cementowo-wapienny	1,5cm

T1 TARAS NA GRUNCIE

Płyty tarasowe	2cm
Podsypka cementowo-piaskowa	3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowaneo mechanicznie	15cm
Grunt rodzimy	

Rysunek należy rozpatrywać równolegle z rysunkami rzutów, przekrojów, opisem architektonicznym oraz projektami branżowymi.

PLANBOX

ARCHITEKCI

PLAN BOX ARCHITEKCI SP. Z O.O.
UL. 6 SIERPNIA 14 LOK.4
90-416 ŁÓDŹ

Faza : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Temat : Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Lokalizacja obiektu :
Skrzynki, gmina Stęszew
dz. nr ewid. 95/40, obręb geod. Skrzynki

Inwestor :
Mateusz Wolski
zam. ul. Nowosolska 21A, 60-171 Poznań

Temat rysunku: Przekrój A-A

Skala: 1:50
Nr rysunku: A-4

Data: 11.2025

Branża : ARCHITEKTURA Projektant:
mgr inż. arch. Aneta Plesiak
nr upr. 1/LOOKK/2014
Podpis:

Branża : KONSTRUKCJA Projektant:
mgr inż. arch. Justyna Świerczyńska
Podpis:

mgr inż. Marcin Kapuściński
nr upr. LOD/0460/POOK/06